

HEAT SINK COMPOUND

Pour couplage thermique et dissipation de la chaleur.

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

Composé pour augmenter la conductivité thermique et la dissipation efficace de la chaleur pour les composants électroniques.

2. CARACTÉRISTIQUES

- Conductivité thermique élevée.
- Excellent effet tampon contre l'humidité.
- Faible taux d'impuretés métalliques.

3. APPLICATIONS

- Circuits imprimés.
- Composants électroniques.
- Assemblages de commande.

4. MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur une surface propre et sèche.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas utiliser sur un équipement sous tension.

Une fiche de données de sécurité (SDS) conforme au règlement européen N° 1907/2006 Art. 31 et ses amendements est disponible pour tous les produits.

5. FICHE PRODUIT TYPE

Aspect :	Pâte.
Couleur :	Blanc.
Odeur :	Odeur caractéristique.
Densité	à 20 °C : 2,3 g/cm ³
Température de fonctionnement :	de -50 °C à 300 °C

FICHE TECHNIQUE 2/2

HEAT SINK COMPOUND

6. EMBALLAGE

Tube : 20G
 100G

Toutes les déclarations contenues dans cette publication sont basées sur notre propre expérience et/ou sur des essais effectués en laboratoire. En raison de la grande diversité des équipements et conditions d'utilisation ainsi que de l'imprévisibilité des facteurs humains impliqués, nous recommandons de tester nos produits dans des conditions réelles avant utilisation. Toutes les informations sont données de bonne foi, mais sans aucune garantie expresse ou implicite. Cette fiche technique peut déjà avoir fait l'objet d'une révision en raison d'une modification de la législation, de la disponibilité des produits ou d'expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, la seule valide, vous sera envoyée sur simple demande ; vous pouvez également la trouver sur notre site Internet : www.crcind.com. Nous vous conseillons de vous inscrire sur ce site Internet afin de recevoir automatiquement les futures mises à jour de ce produit.

Version : 4.2
Date : 20/05/2022

